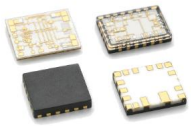
Produktkatalog

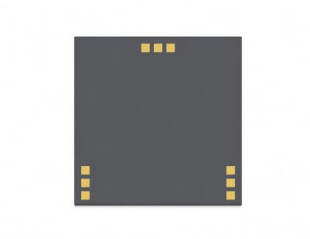
Integrierte passive HF-Bauelemente

Integrierte passive Bauelemente vereinen mehrere passive Elemente auf einem Substrat oder in einem Gehäuse. HF-Ausführungen übernehmen Anpassung, Filterung, Balun-Funktion oder Kopplung.



Produkte: 32

Revision: 11 · Revisionsdatum: 2026-11-11



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 2 × 2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 3700; Maximum: 5000; Wert: 3700–5000; Einheit: MHz

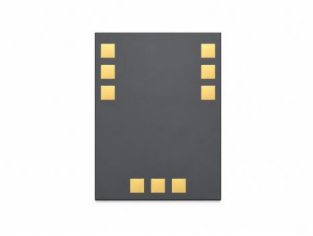
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 14 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 500; Maximum: 2700; Wert: 500–2700; Einheit: MHz

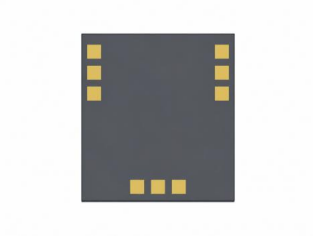
Isolation: Typisch: 14; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 18 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 800; Maximum: 2000; Wert: 800–2000; Einheit: MHz

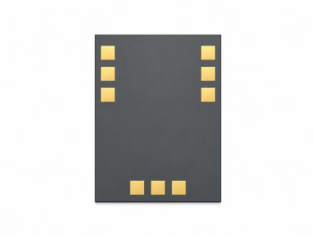
Isolation: Typisch: 18; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 18 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.4 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.4 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 1000; Maximum: 4000; Wert: 1000–4000; Einheit: MHz

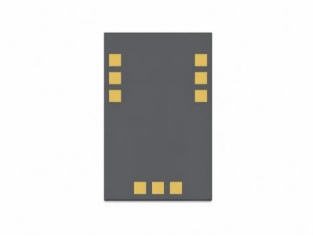
Isolation: Typisch: 18; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.4

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.4

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

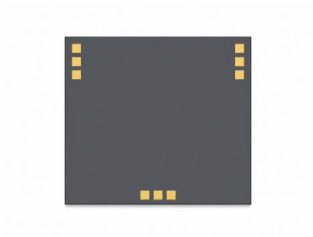
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

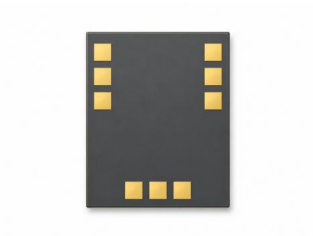
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 30 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.1 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

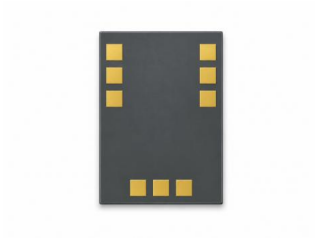
Isolation: Typisch: 30; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.1

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.1 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 5000; Maximum: 7000; Wert: 5000–7000; Einheit: MHz

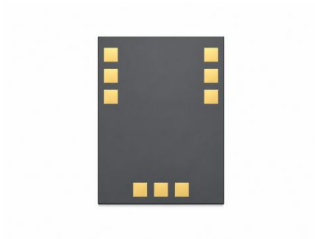
Isolation: Typisch: 25; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.1

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 5000; Maximum: 13000; Wert: 5000–13000; Einheit: MHz

Isolation: Typisch: 25; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

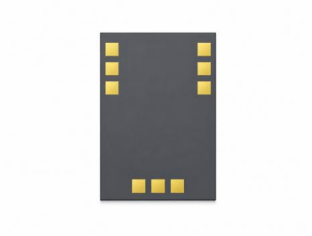
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

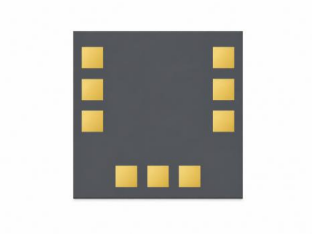
Isolation: Typisch: 25; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

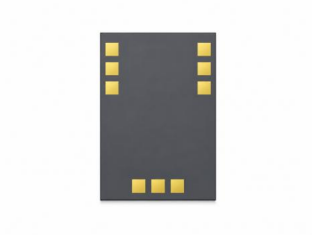
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 30 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 10000; Maximum: 20000; Wert: 10000–20000; Einheit: MHz

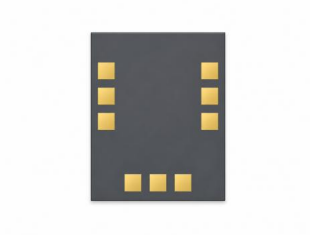
Isolation: Typisch: 30; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 12000; Maximum: 18000; Wert: 12000–18000; Einheit: MHz

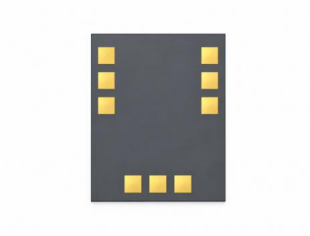
Isolation: Typisch: 25; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 30000; Maximum: 40000; Wert: 30000–40000; Einheit: MHz

Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 0 dB

Dämpfung: 0 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.2 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 0; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.2

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 1 dB

Dämpfung: 1 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 1; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 2 dB

Dämpfung: 2 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 2; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 3 dB

Dämpfung: 3 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 3; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 4 dB

Dämpfung: 4 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 4; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 8 dB

Dämpfung: 8 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 8; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 16 dB

Dämpfung: 16 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 16; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 0 dB

Dämpfung: 0 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.6 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 0; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.6; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 1 dB

Dämpfung: 1 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.4 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 1; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.4

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 2 dB

Dämpfung: 2 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 2; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.35

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 3 dB

Dämpfung: 3 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 3; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.35

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 5 dB

Dämpfung: 5 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 5; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 6 dB

Dämpfung: 6 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 6; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.35

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 8 dB

Dämpfung: 8 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 8; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 10 dB

Dämpfung: 10 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

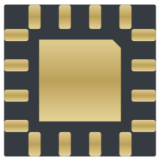
Dämpfung: Wert: 10; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCXOV-DC-40000-C

DC–40000 MHz Gehäuste RF-Kreuzung — ISO 30 dB (typisch)

DC–40000 MHz; Einfügedämpfung -1.4 dB (typisch); Isolation 30 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: DC; Maximum: 40000; Wert: DC–40000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: -1.4; Einheit: dB

Isolation: Typisch: 30; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.